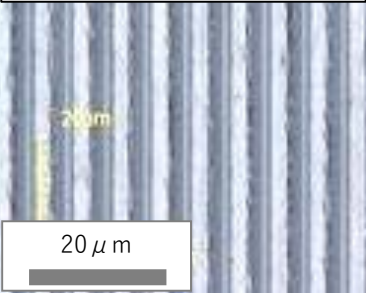
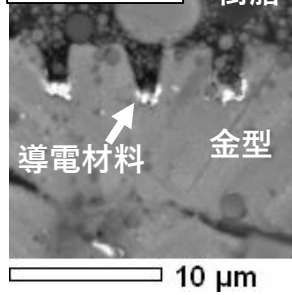


金型 ライン/スペース = 3/3 μm



断面SEM

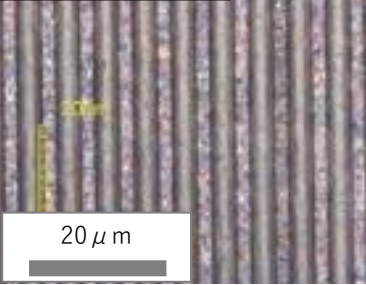


■ 樹脂への微細構造転写技術

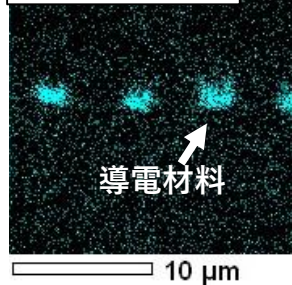
<応用例>

- ・ 配線一体樹脂フレキシブル基盤
- ・ 光学素子(レンズ、光学フィルム)
- ・ 生体用マイクロニードル

樹脂転写表面



断面元素分析



□要素技術

- ・ 金型微細加工技術
- ・ 材料に合わせた転写成形技術
- ・ 配線一体成形, 包埋技術
- ・ 評価、解析技術

世界最細の配線インプリント成形

量産・低コストを目指す樹脂の マイクロ・ナノ加工

■ プラスチック表面機能化技術

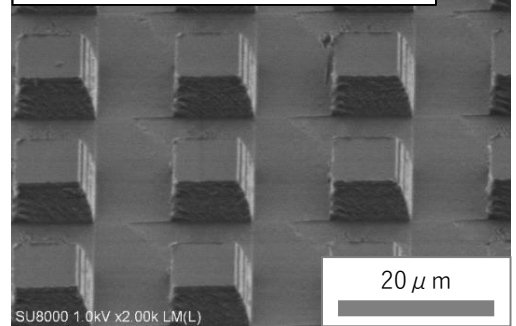
<応用例>

- ・ マイクロ流路の流動(濡れ性)制御
- ・ 溶液塗布エリアの制御
- ・ 結露や冰雪付着抑制機能

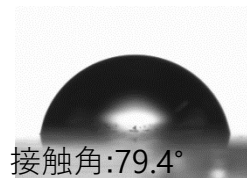
□要素技術

- ・ 金型微細加工技術
- ・ 材料に合わせた転写成形技術
- ・ 親水-疎水の物理-化学的表面処理技術
- ・ 評価、解析技術

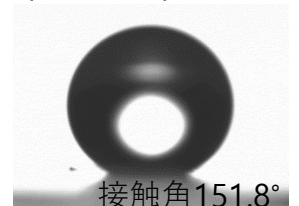
樹脂転写表面(ピラー形状)



ピラー形状: 高さ5μm, 幅10μm



平面基盤



超撥水表面

(ピラー形状 + 撥水表面処理)